

WS770 无 VOC 液态助焊剂

特性

- ▶ 无 VOC
- ▶ 高活性
- ▶ 兼容无铅或有铅合金
- ▶ 良好的润湿性适用于所有表面处理
- ▶ 清洗时低泡沫
- ▶ 宽广的工艺窗口
- ▶ 残留物易清除

描述

WS770 是一款有机活性，水基，无 VOC 的水溶液态助焊剂。WS770 是一款缓冲助焊剂，提供宽广的活性范围和良好的润湿性，可消除常见缺陷，如拖尾，拉尖和锡球。WS770 在常用的表面处理和阻焊膜上都表现良好，能实现优良的通孔填充效果。WS770 残留物必须直接用去离子水清除。

特点



处理及储存

参数	时间	温度
密封储存保质期	6 个月	室温

WS770 在室温下可密封存储 6 个月。不要靠近火源或易燃物品，避免光照，以免降低产品质量。WS770 可以直接使用，不需要搅拌。不要将使用过和未使用的产品混合装在相同的容器内，请重新密封已开容器。储存条件范围 4-40°C (40-100°F)。

应用

WS770 的应用方式为喷雾，刷，薄雾，和蘸。WS770 可以从容器中取出直接使用，不用稀释。当喷洒助焊剂时，必须适当的均匀覆盖。干燥助焊剂覆盖起始时建议每平方英寸涂抹 500-1500 毫克。当使用氮气密封波峰焊设备时，通常需要增加助焊剂用量。

工艺指导

将热电偶贴附于 PCB 的上表面，其温度应该在 100-135°C (212-275°F) 之间。对于所有水溶性助焊剂，对流型预热设备能提供一个更广的工艺窗口。确保助焊剂在接触波峰前完全烘干，预热未干的助焊剂会引起飞溅。少量出烟是正常现象。推荐的接触时间取决于波峰配置、炉温、合金类型和热装配。典型的推荐值为 4 - 7 秒。请访问 <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts> 联系 AIM 技术支持以获得工艺协助。

清洁

WS770 残留物必须清除。直接使用去离子水或皂化剂，内嵌式或批量清洗均可接受。推荐使用去离子水做最后冲洗。残留物应该在 8 小时内清除。请联系 AIM 以获得清洁推荐信息。

安全
保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。

测试数据小结

名称	测试方法	结果
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ORH1
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1	ORH1
名称	测试方法	结果
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	高
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	高
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	>2.0%
定量卤化物, 铬酸银	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	有卤
定量卤化物, 氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	通过
表面绝缘电阻 (清洁后)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	8.94 典型值
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	30.7 mg KOH per gram flux 典型值
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	1.02 典型值
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	无色
润湿性	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过